附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
|  | 国标委发[2022]17号  20220134-T-469 | 碳化硅外延片 | 南京国盛电子有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0084T-YS | 红外及激光材料用硒化氢 | 广东先导稀材股份有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]158号2022-0573T-YS | 半绝缘砷化镓单晶衬底片 | 广东先导微电子科技有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]28号  20214216-T-469 | III族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 预审 |
|  | 正在公示  2023000382 | 碳化硅单晶片厚度和平整度测试方法 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 讨论 |
|  | 正在公示  2023000387 | 碳化硅单晶片微管密度测试方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 讨论 |